

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

公告编号：2026-04-012

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,699,673,563 为基数¹，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	兴森科技	股票代码	002436
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋威	陈小曼、陈卓璜	
办公地址	深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 8 楼	深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 8 楼	
传真	0755-26613189	0755-26613189	
电话	0755-26634452	0755-26062342	
电子信箱	stock@chinafastprint.com	stock@chinafastprint.com	

¹ 需扣除公司回购专户持有的股份数量。

2、报告期主要业务或产品简介

公司秉承“助力电子科技持续创新”的使命，确立了“全球先进电子电路方案数字制造领军者”的全新愿景，明确了“顾客为先、高效可靠、持续创新、共同成长”的核心价值观，确立了“用芯连接数字世界”的全新品牌主张。

公司主营业务聚焦于“先进电子电路”和“数字化制造”两大战略方向，经过 32 年的持续深耕与发展，公司具备覆盖先进电子电路全类别产品的技术能力，基于 Tenting 减成法、Msap 改良半加成法和 SAP 半加成法工艺的持续精进，涵盖传统高多层 PCB 板、软硬结合板、高密度互连 HDI 板、类载板（SLP）、ATE 半导体测试板、封装基板（含 CSP 封装基板和 FCBGA 封装基板）等全类别产品，可为客户提供研发—设计—制造—SMT 贴装的一站式服务。在数字制造领域，公司依托于广州基地 P10 工厂的数字化转型经验，完成了标准化、自动化系统的开发与部署；在工厂数字化转型层面，由业务主导、数字化赋能，通过数据标准化和流程精益化将经验固化为规则、控制变异点，实现高效可靠的量产能力和领先的经营效率。

报告期内公司经营模式未发生重大变化。公司日常生产以客户订单为基础，采用“以销定产”的经营模式，以“先进电子电路方案”匹配客户的产品开发需求，以“数字化制造”打造可靠量产能力和具备竞争力的质量、交付和成本保障。传统 PCB 业务聚焦于样板快件及批量板的研发、设计、生产、销售和表面贴装，以工厂主导、数字化赋能的模式深化推进数字化转型，持续提升客户满意度和经营效率。在高阶 PCB 领域，完善 Anylayer HDI 板和类载板（SLP）业务布局，在坚守高端智能手机主赛道的基础上，全力拓展高端光模块、毫米波通信及 AI 硬件市场。半导体业务聚焦于 IC 封装基板（含 CSP 封装基板和 FCBGA 封装基板）和半导体测试板领域，立足于芯片封装测试环节的关键材料自主配套。公司产品广泛应用于通信设备、消费电子、工业控制、医疗电子、服务器、轨道交通、计算机应用、半导体等多个行业领域。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产	15,081,816,914.81	13,668,277,183.53	10.34%	14,935,398,718.36
归属于上市公司股东的净资产	5,348,263,177.00	4,935,486,892.13	8.36%	5,333,940,140.88
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入	7,194,624,804.67	5,817,324,197.22	23.68%	5,359,923,893.28
归属于上市公司股东的净利润	134,946,022.66	-198,289,785.26	168.05%	211,212,047.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,005,996.98	-195,768,453.58	172.03%	47,763,493.83
经营活动产生的现金流量净额	-62,747,124.30	375,814,830.73	-116.70%	125,467,202.79
基本每股收益（元/股）	0.08	-0.12	166.67%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.08	-0.12	166.67%	0.13
加权平均净资产收益率	2.60%	-3.90%	6.50%	3.41%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,579,603,763.29	1,846,259,672.66	1,947,164,444.92	1,821,596,923.80
归属于上市公司股东的净利润	9,372,438.91	19,460,510.24	102,658,486.21	3,454,587.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,899,959.42	39,839,425.60	101,971,476.08	-7,704,864.12
经营活动产生的现金流量净额	16,926,344.30	-185,912,450.48	47,185,567.73	59,053,414.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	108,937	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	147,330	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
邱醒亚	境内自然人	13.79%	234,462,652	183,319,914	质押	55,450,000	
晋宁	境内自然人	3.94%	66,902,828	0	不适用	0	
叶汉斌	境内自然人	3.67%	62,386,996	0	不适用	0	
张丽冰	境内自然人	2.36%	40,157,000	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.83%	31,040,114	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.47%	25,022,210	0	不适用	0	
金宇星	境内自然人	1.14%	19,416,261	0	不适用	0	
平安银行股份有限公司—永赢科技智选混合型发起式证券投资基金	其他	0.53%	9,855,300	0	不适用	0	
章瑗	境内自然人	0.51%	8,676,400	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司—汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.51%	8,627,821	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东金宇星通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 18,946,400 股，通过普通证券账户持有公司股份 469,861 股，合计持有公司股份 19,416,261 股。 股东章瑗通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,211,400 股，通过普通证券账户持有公司股份 465,000 股，合计持有公司股份 8,676,400 股。						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、变更部分募集资金用途

2024 年 2 月 27 日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司募投项目“宜兴硅谷印刷电路板二期工程项目”（以下简称“原募投项目”）主要生产 PCB 多层板，投产后将新增 8 万平方米/月的印刷电路板产能。鉴于目前 PCB 行业面临需求不振、竞争加剧、增长不达预期的现状，公司经审慎研究，认为如按原规划实施可能存在产能消化风险、成本代价逐步增加、未能达到预期效益等不利情形。为提高募集资金使用效率、保障主营业务长远发展以维护全体股东利益，同意公司放缓原募投项目投资节奏，并将尚未投入的 29,500 万元募集资金用于收购广州兴科半导体有限公司 24%股权。截至本报告披露日，公司已取得广州兴科 24%股权并完成了股东变更相关的工商登记手续和公司章程备案。

2、终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金

2025 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“宜兴硅谷印刷电路板二期工程项目”主要生产 PCB 多层板，投产后将新增 8 万平方米/月的印刷电路板产能。鉴于目前 PCB 行业缓慢复苏的现状，公司经审慎研究，认为如按原规划实施可能存在产能消化风险、成本代价逐步增加、未能达到预期效益等不利情形。为保障主营业务长远发展及维护全体股东利益，同意公司终止该项目募集资金投入，并将该项目剩余的募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至本报告披露日，公司已将前述项目剩余资金全部用于永久补充流动资金，项目相关募集资金专户已注销。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

法定代表人：

邱醒亚

二〇二六年四月二十三日

